

## 한국팹리스산업협회 회원사 독일 뮌헨 박람회 참가 프로그램

한국팹리스산업협회는 유럽 최대 반도체 박람회 중 하나인 **뮌헨 반도체 박람회 2023 (SEMICON EUROPA 2023)** 및 이와 연계한 한독 반도체 산업 컨퍼런스 참가 프로그램을 통해 회원사들이 최신 반도체 산업 기술과 제품의 동향을 파악하고 유럽 현지 고객을 발굴하는 기회를 갖게 하고자 합니다.

### 프로그램 1: 독일 뮌헨 박람회 참관

뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회 2023 (PRODUCTRONICA 2023)

<https://productronica.com/>

뮌헨 반도체 박람회 2023 (SEMICON EUROPA 2023)

<https://www.semicon.europa.org>



### 1) 박람회 소개:

**뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회(PRODUCTRONICA)**는 세계 최대의 전자제품 생산, 조립 및 부품 제조에 초점을 맞춘 전시회로, 전자 제조 업계의 최신 기술, 소프트웨어 및 솔루션을 선보이는 국제적인 장입니다. 40여개국에서 900여개 기업 및 기관이 전시에 참여하고, 70여개국에서 2만 명의 전자산업 관계자들이 전시회를 방문합니다.

뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회와 함께 뮌헨 반도체 박람회(SEMICON EUROPA)도 개최됩니다. 이 박람회는 세계적으로 유명한 반도체 및 전자 기술 산업의 중요한 행사 중 하나로 반도체 산업의 혁신과 발전을 위한 중요한 플랫폼으로 역할하고 있습니다. 이 박람회는 독일 뮌헨에서 매년 개최되며 반도체 제조, 설계, 재료, 장비, 시스템 등 반도체 분야 전반에 걸친 전시, 세미나, 워크샵, 기술 발표 등의 다양한 행사를 제공합니다. 참가 기업 및 기관들은 최신 기술과 제품의 동향을 파악하고 비즈니스 협력 관계를 구축할 기회를 가질 수 있습니다.

2) 개최기간: 2023년 11월 14일(화) -17일(금)

3) 전시장소: 독일 뮌헨 박람회장 (Messe München)

4) 개최규모: 참가기업 약 900개사

참가자 약 2만명

(2021년, 뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회 기준)

5) 전시부문:

#### **Manufacturing**

Semiconductor Device Manufacturing(IDM, Foundry), Packaging, Assembly & Test Services, Electronics Manufacturing Services(EMS), LED/MEMS/PV/Display Manufacturing, Fabless Semiconductor Manufacturing

#### **Equipment**

Wafer Processing, Front-end Inspection & Measurement, Metrology, Assembly & Packaging, Test, Factory Automation, Robots, Printing, Coating, Roll-to-Roll Equipment, Secondary

#### **Materials**

Photolithography, Deposition Materials, Gases, Liquids, Chemicals, Solids, Assembly & Packaging Materials, Consumables(Test and Process), LED/MEMS/PV/Display Materials, Wafer and Silicon Related Substrates, Pastes & Printing

#### **Sub-systems/components/other**

R&D, Technology Transfer, Electronic Components & Instrumentation, Manufacturing Services and Consulting(Directly related to mfg.), Sub-systems, Outsources Manufacturing, General Business Services, Consulting

#### **Design**

Software, EDA, Modeling, Fabless, Other Design/Software

## 6) 박람회 참관 일정

| 일 자         | 지 역                                    | 세부일정                                               |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11월 13일 (월) | 인천<br>프랑크푸르트(Frankfurt)<br>뮌헨(München) | 인천 출발<br>프랑크푸르트 도착 - 뮌헨 이동                         |
| 11월 14일 (화) | 뮌헨(München)                            | 뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회, 뮌헨 반도체 박람회 참관                 |
| 11월 15일 (수) | 뮌헨(München)                            | 뮌헨 전자제품 개발 및 생산 박람회, 뮌헨 반도체 박람회 참관                 |
| 11월 16일 (목) | 독일 기관 방문 지역                            | 독일 프라운호퍼 연구소(Fraunhofer Institute)/<br>기타 유관 기관 방문 |
| 11월 17일 (금) | 프랑크푸르트(Frankfurt)                      | 프랑크푸르트 이동 및 출발                                     |
| 11월 18일 (토) | 인천                                     | 인천 도착 후 해산                                         |

\* 본 참관 행사는 최저 참가 인원 10명 이상일 경우 진행할 예정입니다.

## 프로그램 2: 한독 반도체 산업 컨퍼런스 및 수출상담회

1) 행사 개요: 코트라(KOTRA) 주최로 세미콘 유럽 2023 전시회 참가 현지 바이어와 국내기업 간 컨퍼런스 및 1:1 비즈니스 상담회 개최

2) 일시: 2023년 10월 18일 (수)

3) 장소: 독일 뮌헨 시내 및 온라인

### 4) 행사 내용

- 컨퍼런스: 구매동향 및 협업전략 소개, 반도체 분야별 기술 동향, 반도체 관련 글로벌 공급망, 진출전략 안내 등  
(온라인/ 오프라인 동시 개최)
- 상담회: 현장 오프라인 1:1 비즈니스 상담회  
(온라인 미팅 가능 여부는 미정)

### 5) 참가기업 및 기관

- 국내 15여개 기업
  - 12개사 확정, 추가 3-4개 참가기업 모집 예정
  - 현지 행사 기준, 온라인 참여는 참가 기업 수 제한 없음
- 해외 반도체·자율주행 분야 20개사 및 유관 기관
  - BMW그룹, Vitesco/Continental, ams OSRAM, Infineon, Intel, ST마이크로일렉트로닉스, 프라운호퍼 연구소, 실리콘 색소니(Silicon Saxony,독일 작센주 반도체얼라이언스) 등

### 6) 코트라 본사 주최 국내 사전 간담회

- 7-8월 중 예정 (추후 일정 공지)
- 국내 행사장에서 코트라 뮌헨 무역관과 온라인 컨퍼런스 형식으로 진행

### 7) 컨퍼런스 프로그램(안)

| 시 간<br>(독일 현지 시간) | 발표 주제                   | 연 사                                                              | 소 속                      |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10:10~10:30       | 한국 반도체 기업과<br>협업 방안     | Senior Manager<br>Technology-Innovation-Transfer                 | Silicon Saxony e.V       |
| 10:30~10:50       | 자율주행 차량용<br>반도체         | Semiconductor Management,<br>BMW Group                           | BMW GROUP                |
| 10:50~11:10       | 글로벌 공급망의<br>한계와 세계화     | Division President & CEO<br>Automotive,<br>Infineon Technologies | Infineon                 |
| 11:10~11:30       | 빅데이터 시대 차세<br>대 메모리 솔루션 | EVP of Solution Product &<br>Development,<br>Samsung Electronics | Samsung<br>Semiconductor |
| 11:30~11:50       | 세정 장비 소개                | Executive Vice President                                         | TES                      |
| 11:50~12:10       | 초미세 전기와<br>미래 컴퓨팅       | Group chairman                                                   | Fraunhofer<br>Institute  |

|             |                                   |                                                                                                                 |                     |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14:00~14:20 | 막테부르크 반도체<br>팹 소개                 | Managing Director,<br>VP and General Manager,<br>Intel Germany                                                  | Intel               |
| 14:20~14:40 | 팹 건설 및<br>시스템 공급자                 | Group Vice President,<br>STMicroelectronics                                                                     | STM                 |
| 14:40~15:00 | 광학 솔루션과<br>자동차 산업의 변화             | Executive Vice President & GM<br>BU Image Sensor Solutions,<br>ams OSRAM                                        | ams OSRAM           |
| 15:00~15:20 | 인스펙션 머신                           | General Manager,<br>Koh Young                                                                                   | Koh Young           |
| 16:00~16:20 | AI 칩 소개                           | CTO & Co-Founder                                                                                                | Semron              |
| 16:20~16:40 | 차량용 반도체 탄화<br>규소(SiC) 파워 디바<br>이스 | Senior Vice President, Head of<br>Product Line Engineering &<br>Manufacturing Services,<br>Vitesco Technologies | Vitesco/Continental |
| 16:40~17:00 | 디자인 하우스 소개                        | General Manager,<br>AD Technology Europe GmbH                                                                   | AD Technology       |

#### 참가 의향서 제출 및 문의

- 첨부한 참가 의향서를 작성 후 7월 31일까지 아래 협회 접수 이메일로 보내주시기 바랍니다.
- 참가 의향서 접수 이메일: [kfia.msk@gmail.com](mailto:kfia.msk@gmail.com)
- 문의: 한국팹리스산업협회  
국제협력전문위원 오정택 010-2660-0845, [ojt3737@gmail.com](mailto:ojt3737@gmail.com)  
경영지원 본부장 문수경 070-4497-5455, [kfia.msk@k-fabless.org](mailto:kfia.msk@k-fabless.org)  
사무총장 김서균 070-4497-5454, [smartlion@k-fabless.org](mailto:smartlion@k-fabless.org)